Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



11) EP 0 705 682 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 10.04.1996 Patentblatt 1996/15

(51) Int Cl.6: **B29C 65/14**, B29C 67/04

(21) Anmeldenummer: 95114417.9

(22) Anmeldetag: 14.09.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE

(30) Priorität: 07.10.1994 DE 4435887

(71) Anmelder: FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. D-80636 München (DE) (72) Erfinder:

Elsner, Peter, Dr.
 D-73271 Holzmaden (DE)

 Eyerer, Peter, Prof. Dr. D-76228 Karlsruhe (DE)

Geissler, Adam, Dr.
 D-76689 Karlsdorf-Neuthard (DE)

(74) Vertreter: Dipl.-Ing. Helner Lichti Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Jost Lempert Dipl.-Ing. Hartmut Lasch Postfach 41 07 60 D-76207 Karlsruhe (DE)

(54) Verfahren zum thermischen Verbinden von Substraten aus Polymeren

(57) Zum Verbinden von wenigstens zwei Substraten aus thermoplastischen Polymeren wird vorgeschlagen, daß wenigstens ein Substrat zumindest an der Grenzfläche zum anderen Substrat wenigstens be-

reichsweise mit einem mikrowellenabsorbierenden Medium beschichtet wird und daß die Substrate unter Kontakt ihrer Grenzflächen in einem Mikrowellenfeld miteinander verschweißt werden.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum thermischen Verbinden von wenigstens zwei Substraten aus Polymeren mittels Mikrowellenenergie unter Verwendung eines mikrowellenabsorbierenden Mediums.

In der Kunststofftechnik spielt das Verbinden von Substraten aus Kunststoffen eine bedeutende Rolle. Bei solchen Substraten kann es sich um dreidimensionale Formkörper, wie Gieß-, Spritzgießteile, Extrusionsteile, um räumlich geformte Vorprodukte, wie Haufwerke, z.B. Granulate und Pulver, um flächige Formteile, wie Platten, Folien, oder schließlich um faserige Formteile handeln. Soweit diese Substrate aus duroplastischen Polymeren bestehen, kommen vornehmlich das mechanische Fügen oder das Verkleben mit oder ohne Zugabe von Lösungsmittel in Frage, bei thermoplastischen Polymeren kommt das Schweißen bzw. Verschmelzen hinzu, da bei Temperaturen wenig oberhalb der Erweichungs- bzw. Schmelztemperatur nur der Molekülverband gelockert, aber nicht geschädigt wird und sich beim Abkühlen wieder rückbildet. Als Schweißverfahren kommen das rein thermische Schweißen oder das Hochfrequenzschweißen in Betracht. Diese Verfahren erfordern eine sehr exakte Temperaturführung, um den Molekülverband nicht nachhaltig zu schädigen. Sie führen auch nur bei bestimmten Werkstoffpaarungen von zueinander "affinen" Polymeren zu befriedigenden Ergebnissen. Auch ist es nicht oder nur mit großem Aufwand möglich, Substrate unterschiedlicher Form, z.B. räumliche und flächige, miteinander zu verschweißen. Bei größeren Volumina der miteinander zu verbindenden Substrate, z.B. eines granularen Haufwerks zu einem räumlichen Formkörper - in diesem Fall ist eher von Sintern als von Schweißen zu reden - ergibt sich eine lange Prozeßdauer, da das gesamte Volumen bei nur mäßiger Wärmezufuhr von außen auf Schmelztemperatur gebracht werden muß. Hier greift man deshalb meist zu Klebstoffen.

Es ist auch schon vorgeschlagen worden, Kunststoffe mittels Mikrowellenenergie zu verschweißen. So ist es bekannt (US 5 338 611), zwischen die Grenzflächen der Substrate eine mit mikrowellenabsorbierendem Ruß gefüllte Folie aus einem mit dem Kunststoff der Substrate mischbaren Polymer einzulegen und den Werkstoffverbund in ein Mikrowellenfeld einzubringen. Mit der Folie wird in die Verbindung ein zusätzlicher Kunststoff eingebracht, der für die Herstellung der Verbindung an sich nicht notwendig ist und somit einen unnötigen Kostenfaktor darstellt. Dies schlägt insbesondere zu Buch, wenn es sich um hochwertige Kunststoffe handelt. Hinzukommen die Kosten für die Herstellung dieser gefüllten Folie. Schließlich lassen sich mit dieser Methode bestimmte Substrate, z.B. Granulate oder andere partikelförmige Kunststoffe, überhaupt nicht miteinander verbinden.

Bei einem anderen bekannten Verfahren zur Herstellung von Verpackungen (DE 40 24 373) werden mikrowellenabsorbierende, oxidkeramische Partikel auf

der den zu verbindenden Flächen abgekehrten Seite der Substrate angeordnet. In diesem Fall muß die an der Verbindungsstelle zu erzeugende Schmelzwärme durch das Substrat hindurchgeleitet werden mit dem zwangsläufigen Ergebnis, daß das Substrat in seiner gesamten Ausdehnung aufgeschmolzen wird. Abgesehen von der auf Folien oder dünnen Platten beschränkten Anwendungsmöglichkeit und dem unnötig hohen Energiebedarf, kommt es aufgrund des Durchschmelzens des Substrates zu unerwünschten Änderungen der technisch-physikalischen Eigenschaften. Bei Kunststoffen, die nach Überschreiten der Schmelztemperatur ihre Molekularstruktur irreversibel ändern, kann dieses Verfahren überhaupt nicht angewandt werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das eingangs genannte Verfahren dahingehend weiterzuentwickeln, daß Substrate beliebiger Form aus Polymeren auf einfache und schnelle Weise miteinander verbunden werden können.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß wenigstens ein Substrat zumindest an der Grenzfläche zum anderen Substrat wenigstens bereichsweise mit dem mikrowellenabsorbierenden Medium unmittelbar beschichtet wird und daß die Substrate unter Kontakt dieser Grenzflächen in einem Mikrowellenfeld miteinander verschweißt werden.

Thermoplastische wie auch duroplastische Polymere sind gegen Mikrowellen im wesentlichen durchlässig. Estritt allenfalls bei längerer Einwirkung eine molekulare Schädigung auf. Erfindungsgemäß wird eine Sensibilisierung durch oberflächiges Auftragen eines mikrowellenabsorbierenden Mediums vorzugsweise in flüssiger bis viskoser Form erreicht, in welchem die Mikrowellenenergie in Wärme umgesetzt und unmittelbar an die Grenzfläche des Substrates, das mit diesem Mittel beschichtet worden ist, sowie in die berührende Grenzfläche des anderen Substrates transportiert und führt dort zum Erweichen und Schmelzen der Polymere. Die Mikrowellenleistung wird in Abhängigkeit von den an der Verbindung beteiligten Polymeren so gesteuert, daß zumindest die gemeinsamen Grenzflächen Schmelztemperatur erreichen und miteinander verschweißen.

Das erfindungsgemäße Verfahren bietet vornehmlich folgende Vorteile:

- Da Polymere im wesentlichen mikrowellendurchlässig sind, können große Substrat-Volumina an ihren Kontaktflächen miteinander verbunden werden. Die Mikrowellenenergie wird gezielt nur an den Flächen, an denen sich das mikrowellenabsorbierende Medium befindet, in thermische Energie umgesetzt, so daß die Polymere auch nur dort in den Schmelz zustand übergeführt werden, ohne daß sie im übrigen in ihrer Molekularstruktur beeinträchtigt werden. Es sind auch keine weiteren Trägermedien notwendig, die zwischen die Grenzflächen eingelegt werden müssen.
- Selbst bei großen Volumina ist die "Schweißzeit" ex-

trem kurz, da die für den Schweißvorgang notwendige thermische Energie nicht transportiert werden muß, sondem am gewünschten Ort und nur dort unmittelbar erzeugt wird.

- Da ein Verschweißen nur dort stattfindet, wo sich das mikrowellenabsorbierende Medium befindet, kann die Schweißverbindung lokal begrenzt werden, also entweder bei großen Kontaktflächen auf diskrete Bereiche oder bei Substraten mit nur wenigen oder kleinen Kontaktflächen auf diese beschränkt werden. Im letztgenannten Fall können die Substrate oder eines von ihnen auf der gesamten Oberfläche mit dem mikrowellenabosrbierenden Medium versehen sein, die dann im Mikrowellenfeld zwar aufschmilzt, sich aber wieder zurückbildet, da ein Verschweißen nur an den Kontaktflächen stattfindet.
- Die Schmelztemperatur läßt sich durch Steuerung der Mikrowellenenergie, insbesondere aber auch wegen der kurzen Einwirkungsdauer sehr exakt einhalten, so daß sich einerseits eine Verbindung optimaler Festigkeit herstellen, andererseits jede molekulare Schädigung vermeiden läßt. Die zu erschmelzende Masse kann auf das für die Herstellung der Verbindung notwendige Miminum beschränkt werden.

In einer bevorzugten Ausführung des Verfahrens ist vorgesehen, daß die Substrate im Mikrowellenfeld unter mechanischem Druck wenigstens auf ihre Kontaktflächen miteinander verschweißt werden.

Durch den mechanischen Druck wird zunächst sichergestellt, daß das mikrowellenabsorbierende Medium im Kontaktbereich der Substrate bzw. dem dort vorhandenen Spalt gleichmäßig verteilt wird, sofern ein gleichmäßiger Auftrag nicht von vornherein vorhanden ist, zum anderen werden die Substrate im schließlich aufschmelzenden Bereich der Grenzflächen zusammengedrückt, so daß die Schmelze beider Substrate ineinander fließt und es nach dem Abkühlen zu einer homogenen, festen Verbindung kommt.

Je nach Struktur des Substrates kann das mikrowellenabsorbierende Medium nur im Bereich der Kontaktflächen wenigstens eines oder auch beider Substrate vollflächig aufgetragen werden.

Eine andere Variante zeichnet sich dadurch aus, daß wenigstens ein Substrat aus einem für das mikrowellenabsorbierende Medium penetrationsfähigen Polymer besteht. In diesem Fall dringt also das mikrowellenaktive Mittel zumindest oberflächennah in das Polymer ein und entfaltet seine Wirkung im Mikrowellenfeld nicht nur an der Grenzfläche, sondern auch in der Tiefe der Oberfläche.

Das mikrowellenabsorbierende Medium können die Kontaktflächen der Polymere benetzende Flüssigkeiten, z.B. Alkohole oder Öle sein. Vorzugsweise aber enthält das Medium Ruß, der lediglich angefeuchtet ist. Hierdurch läßt sich vor allem die Schweiß- bzw. Sinterzeit

auf ein Minimum reduzieren, da eine schnelle Umwandlung der Mikrowellenenergie in thermische Energie stattfindet. Ein weiterer positiver Effekt ist folgender: Aufgrund der Plättchenstruktur von Ruß einerseits und der Oberflächenspannung der Polymerschmelze andererseits sinken die Rußpartikel in die Schmelze ein, so daß sie das Verfließen der Schmelze im Bereich der Kontaktflächen nicht behindern, Fehlstellen in der Verbindung also nicht entstehen. Sind die Substrate nicht nur im Bereich der gemeinsamen, miteinander zu verbindenden Grenzflächen mit dem mikrowellenabsorbierenden Medium beschichtet, wo die Rußpartikel am fertigen Produkt ohnehin nicht stören, so verschwinden sie auch in den übrigen Bereichen unter die Oberfläche, so daß sich deren ursprüngliche Beschaffenheit und Eigenschaften nach dem Abkühlen wieder einstellen. Durch das Absinken unter die Oberfläche wandert die eigentliche Wärmequelle in die Tiefe des Substrates, so daß die Schmelz front entsprechend nach innen wandert, was für eine innige Verbindung der Substrate sorgt. Schließlich ist Ruß ein umweltfreundliches, gegebenenfalls vom Polymer auch leicht zu trennendes Material, so daß es keine zusätzliche Belastung beim Recycling der Polymere darstellt.

Die Schweiß- bzw. Sintertemperatur läßt sich, wie schon angedeutet, problemlos auf die Erweichungsbzw. Schmelztemperatur der an der Verbindung beteiligten Polymere einstellen. Dies läßt sich dadurch erreichen, daß die Energie des Mikrowellenfeldes und/oder die Verweilzeit der Substrate im Mikrowellenfeld und/oder die Menge des mikrowellenaktiven Materials gesteuert wird.

Das Verfahren nach der Erfindung läßt sich bei Substraten unterschiedlichster Struktur ausführen. So kann wenigstens ein Substrat aus einer Folie oder aus Partikeln bestehen oder ein räumlicher Formkörper sein, der zur Gänze aus dem Polymer besteht oder lediglich mit einem solchen beschichtet ist. Insbesondere bietet das Verfahren die Möglichkeit, modale oder bimodale Substrate, also beispielsweise Granulate verschiedener Korngröße, aber auch Substrate unterschiedlicher Form, z.B. Granulate mit Folie oder Folie mit räumlichen Formkörpern oder solche Formkörper mit Granulaten, zu verbinden. Es lassen sich folglich auch Verbunde herstellen, die bisher nicht oder nur mit größtem Aufwand zu erzeugen waren. Nur beispielhaft sei erwähnt, daß beispielsweise auf einem räumlichen Formkörper, also einem beliebigen Werkstück, eine Dämpfungsschicht aus, gegebenenfalls geschäumtem, Granulat aufgebracht und dieses gegebenenfalls noch durch eine Folie abgedeckt werden kann. In diesem Fall kann es ausreichen, nur das Granulat mit dem mikrowellenabsorbierenden Medium zu beschichten, um im Mikrowellenfeld die Grenzflächen zwischen dem Granulat einerseits und dem Formkörper bzw. der Folie andererseits aufzuschmelzen

In einer bevorzugten, aber wiederum nur beispielhaften Ausführung dient das Verfahren zur Herstellung

20

poriger Formkörper, indem modale oder bimodale, partikelförmige Substrate, z.B. Granulate verwendet werden, wenigstens ein Teil der partikelförmigen Substrate mit dem mikrowellenabsorbierenden Medium versetzt wird und mit dem restlichen Substrat gemischt und die Mischung unter Einwirkung von mechanischem Druck dem Mikrowellenfeld ausgesetzt wird.

Auf diese Weise lassen sich Filtermaterialien, Verpackungs- oder Dämmmaterialien aus sortenreinen und damit in einfacher Weise recyclebaren Polymeren herstellen. Auch hierbei wird der oben genannte Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besonders augenfällig, indem bei kurzer Verweilzeit im Mikrowellenfeld große Volumina poriger Formkörper erzeugt werden können und in sämtlichen Volumenquerschnitten eine gleichermaßen gute Verbindung der Partikel bzw. Granulate vorhanden ist

Patentansprüche

- Verfahren zum thermischen Verbinden von wenigstens zwei Substraten aus Polymeren mittels Mikrowellenenergie unter Verwendung eines mikrowellenabsorbierenden Mediums, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Substrat zumindest an der Grenzfläche zum anderen Substrat wenigstens bereichsweise mit dem mikrowellenabsorbierenden Medium unmittelbar beschichtet wird und daß die Substrate unter Kontakt ihrer Grenzflächen in einem Mikrowellenfeld miteinander verschweißt werden.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Substrate im Mikrowellenfeld unter mechanischem Druck wenigstens auf ihre Kontaktflächen miteinander verschweißt werden.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das mikrowellenabsorbierende Medium auf die Kontaktflächen des Substrates vollflächig aufgebracht wird.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Substrat aus einem für das mikrowellenabsorbierende Medium penetrationsfähigen Polymer besteht.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das mikrowellenabsorbierende Medium eine die Oberfläche des Substrates benetzende Flüssigkeit ist.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das mikrowellenabsorbierende Medium Ruß enthält.
- Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß als mikrowellenabsorbierendes Medium

mit einer Flüssigkeit versetzter Ruß verwendet wird.

- Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Ruß in der Flüssigkeit mit weniger als 1 Massen-% enthalten ist.
- 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatur an den Kontaktflächen der Substrate durch die Energie des Mikrowellenfeldes und/oder die Verweilzeit der Substrate im Mikrowellenfeld und/oder die Menge des mikrowellenabsorbierenden Mediums gesteuert wird.
- 15 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Substrat eine Folie ist.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Substrat aus Partikeln besteht.
 - 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichent, daß wenigstens ein Substrat ein Formkörper ist, der aus einem Polymer besteht oder mit einem solchen beschichtet ist.
 - 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12 zur Herstellung von porigen Formkörpem, dadurch gekennzeichnet, daß modale oder bimodale, partikelförmige Substrate verwendet werden, wenigstens ein Teil der partikelförmigen Substrate mit dem mikrowellenabsorbierenden Medium versetzt und dieser Teil mit dem restlichen Substrat gemischt und die Mischung unter Einwirkung von mechanischem Druck dem Mikrowellenfeld ausgesetzt wird.
 - Verfahren nach Anspruch 13 zur Herstellung von Filtermaterial aus Granulaten thermoplastischer Polymere.
 - Verfahren nach Anspruch 13 zur Herstellung von Verpackungsmaterial aus Granulaten der Polymere.
 - Verfahren nach Anspruch 13 zur Herstellung von mechanisch oder thermisch wirksamem Dämmaterial aus Polymeren.

4



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 95 11 4417

	EINSCHLÄGIG				
Kategorie	Kennzeichnung des Dokume der maßgeblic	nts mit Angabe, soweit erforderlich, hen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IntCL6)	
X	GB-A-2 182 599 (POR 20.Mai 1987 * Beispiel 7 *	1-9, 11-16	B29C65/14 B29C67/04		
X	FR-A-2 490 057 (APP FSE) 12.März 1982	LIC MICRO ONDES STE	1-12	*	
A	* Ansprüche 1,2,4-6	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13-16		
X	DE-A-14 79 239 (FAR VORM. MEISTER LUCIU 1969 * Ansprüche 1,6 *	1-16			
D,X	DE-A-40 24 373 (MAJER CHRISTIAN GMBH CO KG) 6.Februar 1992 * Ansprüche 1,2 *		1,2,9, 10,12		
P,X	DE-A-43 16 015 (AKZO NOBEL NV) 17.November 1994 * Ansprüche *		1,4	RECHERCHIERTE	
X	US-A-4 376 005 (VITELLARO FRANK A) 8.März 1983 * Zusammenfassung; Abbildung 1 *		1,4	SACHGEBIETE (Int.Cl.6) B29C	
X	EUREKA (INC ENGINEERING MATERIALS AND DESIGN)., Bd. 12, Nr. 11, 1.November 1992 KENT GB, Seite 21 XP 000323359 'CONDUCTIVE POLYMERS SPEED PLASTIC WELDING' * Absatz 1 * * Absatz 8 *		1-3,10,		
X	GB-A-2 262 258 (COOKSON GROUP PLC) 16.Juni 1993 * Ansprüche *		1-3,9, 10,12		
Der vo	rliegende Recherchenbericht wurd	e für alle Putentansprüche erstellt			
	Retherchenort	Abschlefichtun der Recherche	<u> </u>	Prefer	
	DEN HAAG	28.Dezember 1995	Cor	denier, J	
X: von Y: von and A: teci O: sic	KATEGORIE DER GENANNTEN I besonderer Bedeutung allein betracht besonderer Bedeutung in Verbindung eren Verbfrentlichung derselben Kate- nologischer Hintergrund hischriftliche Offenbarung ischenliteratung	E: ilteres Patentdol et nach dem Anmel mit einer D: in der Anmeldun gorie L: aus andern Grin	ument, das jedo dedatum veröffer g angeführtes D den angeführtes	itlicht worden ist okument	



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 95 11 4417

Kategorie	Kennzeichnung des Doku	GE DOKUMENTE ments mit Angabe, soweit erforderlich,	Betrifft	KLASSIFIKATION DER
Α .		REUDENBERG CARL FA)	Anspruch	ANMELDUNG (Int.CL6)
A	DE-C-886 511 (DYN. VORMALS ALFRED NO! * Ansprüche *	AMIT-ACTIEN-GESELLSCHAFT BEL & CO.) 30.Juni 1938	1,5-8	
A	US-A-3 461 014 (J/ 1969 * Spalte 14, Zeile	 AMES ALBERT L) 12 August 43 - Zeile 58 *	1,5-8	
A .	1968	HITE JEROME R) 9.Juli. 59 - Spalte 6, Zeile 4;	1,5,6	÷
A	DE-A-31 07 489 (VE INST FU) 16.Septem * Ansprüche 1,8 *	R ZUR FOERDERUNG DES aber 1982	13-16	,
A	DE-A-28 51 612 (BC 1980 * Seite 3, Absatz	DLDT WILFRIED) 12.Juni 4-5 *	13-16	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.6)
A	US-A-4 375 441 (AE 1.März 1983 * Ansprüche 1,14 *	AMS RICHARD C ET AL)	13-16	
4	US-A-3 443 492 (PL 1969 * Anspruch 1; Abbi	EASS CHARLES M) 13.Mai	13-16	
ŀ	19/3	ICO ENG) 12.Dezember 0 - Zeile 34; Anspruch 1	13-16	
		-/		
Der vor	tiegende Recherchenbericht wur	rde für alle Patentansprüche erstellt	1	
	Racherchesort	Abschlaßdatum der Recherche		Profes
	DEN HAAG	28.Dezember 1995		denier, J

EPO FORM 1503 03.82 (PO4CO)



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP **95 11 441**7

Kategorie	EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE Kennzeichnung des Dokuments mit Angahe, soweit erforderlich, Betrifft						KLASSIFIKATION DER
	•	der maßgeblicher	Telle			Anspruch	ANMELDUNG (IntCL6)
A	FR-A-1 438 * Anspruch	276 (ROYAL 4D; Abbild	. LUMIÈRE) lungen *	13.Mai	1966	13-16	
						r	•
		•				,	
							RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
							SACTIGEBLETE (IDL.CLO)
			•				
						*	
Der vo	rtiegende Recherche	nhericht wurde fi	ir alie Patentano	prücke erste	llt		
	Recherchemet			dam der Rachero	- 1	<u></u>	Profer
	DEN HAAG	}	• •	zember		Carr	denier, J
X:von Y:von and A:tech	KATEGORIE DER GI besonderer Bedeutung besonderer Bedeutung eren Veröffentlichung notogischer Hintergru htschriftliche Offenbar	allein betrachtet In Verbindung mit derselben Kategoriend	UMENTE	T: der Erfi E: älteres l nach de D: in der A L: aus and	ndung zug Patentdok m Anmeld nameldung ern Gründ	grunde liegende 'I ument, das jedoc ledatum veröffen g angeführtes Do len angeführtes I	Theorien oder Grundsätze th erst am oder tlicht worden ist kument

PO FORM 1503 03.82 (P04C)